

国浩律师（深圳）事务所

关于

珠海市杰理科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

补充法律意见书

（二）



深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE 邮编：518034
42、41、31DE, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China
电话/Tel: (+86) (755) 8351 5666 传真/Fax: (+86) (755) 8351 5333
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

2022 年 4 月

致：珠海市杰理科技股份有限公司

国浩律师（深圳）事务所
关于
珠海市杰理科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
补充法律意见书
（二）

GLG/SZ/A3267/FY/2022-175

国浩律师（深圳）事务所依据与珠海市杰理科技股份有限公司签订的《法律服务合同》，担任珠海市杰理科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的专项法律顾问，出具了《国浩律师（深圳）事务所关于珠海市杰理科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）、《国浩律师（深圳）事务所关于珠海市杰理科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《国浩律师（深圳）事务所关于珠海市杰理科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）。

2022年1月14日，深圳证券交易所上市审核中心出具《关于珠海市杰理科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核问询函》（审核函〔2022〕010054号）（以下简称“《第二轮审核问询函》”），故本所律师针对《第二轮审核问询函》中要求发行人律师发表意见的事项进行了核查，并就前述事宜出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书作为《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》的补充，不一致之处以本补充法律意见书为准；本补充法律意见书未及内容，以《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》为准。在本补充法律意见书中，除非上下文另有说明，所使用的简称、术语和定义与《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》中使用的简称、术语和定义具有相同的含义，本所在《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》中声明的事项适用于本补充法律意见书。

目 录

第一节 正文.....5

一、《第二轮审核问询函》第 6 题（1）（2） 5

第一节 正文

一、《第二轮审核问询函》第6题（1）（2）

申请文件及首轮问询回复显示：

（1）2021年3月上海华虹、小米科技入股发行人，2020年深圳展想入股发行人。

上海华虹（SS）穿透后的股东为华虹集团、华力微和华虹宏力。报告期内，发行人的晶圆制造供应商华力微、华虹宏力、华力集和无锡华虹均系华虹集团下属企业，与上海华虹（SS）构成关联方。

小米科技穿透后的最终股东为小米集团（1810.HK），深圳展想穿透的股东为传音控股（688036.SH）。报告期内，小米集团、传音控股 TWS 蓝牙耳机等产品存在采用发行人 SoC 芯片的情况。

（2）发行人说明，“随着公司经营规模的快速扩展，自2019年一季度以来公司向华虹集团采购金额逐步增长”。2021年1-9月发行人向华虹集团采购金额合计116,989.90万元，同比增长115.42%；同期发行人收入同比仅增长36.32%。报告期各期发行人向华虹集团采购占比分别为40.87%、29.69%、52.15%、60.96%。

（3）2021年1-9月发行人向华虹集团采购55nm、40nm晶圆单价分别变动-2.28%、0.09%，同期采购的28nm晶圆单价变动10.78%。

请发行人：

（1）说明相关有股权关系的供应商、客户入股发行人的背景、相关方集中入股发行人的原因，各期与发行人交易金额及占同类交易比例；相关方向发行人采购、销售的决策模式，是否由相关股东或其关联方主导。

（2）结合与华力微、华虹宏力、华力集和无锡华虹等的合作时间、报告期各期采购金额、各季度采购同比及环比变动情况、入股前后采购金额及变动情

况等，说明上海华虹入股发行人前后向发行人销售金额是否发生明显变化，是否与华虹集团就采购价格、金额等进行相关利益安排。

（3）说明 2021 年以来向华虹集团的采购金额大幅增加且增幅明显高于收入增长的合理性。

（4）结合相关晶圆市场价格、华虹集团向其他同行业公司销售价格等，分析说明 2021 年 1-9 月在向华虹采购的 28nm 晶圆单价大幅上升情形下，向其采购的主要原材料 55nm、40nm 晶圆单价下滑或几乎持平的合理性，与市场价格、该供应商对其他客户销售价格是否存在明显差异，采购价格是否公允。

（5）结合向小米集团、传音控股等客户各期销售金额、销售单价及同期对其他客户同类产品销售单价的差异及差异比例等，分析说明销售价格是否公允。

请保荐人发表明确意见，请发行人律师对问题（1）、（2）发表明确意见，请申报会计师对问题（2）、（4）、（5）发表明确意见。

请保荐人、发行人律师按照《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》《监管规则适用指引——发行类第 2 号》的要求，逐条认真落实核查工作，完善专项核查报告。

回复意见：

（一）核查方式

1. 查阅发行人的工商登记档案资料；
2. 查阅发行人与上海华虹、小米科技、深圳展想分别签订的《投资协议》《股东协议》《终止特殊股东权利之协议》；
3. 访谈发行人主要管理人员，了解上海华虹、小米科技、深圳展想等投资者集中入股发行人的原因、相关方向发行人采购、销售的决策模式以及发行人与华力微、华虹宏力、华力集和无锡华虹等的合作时间、合作情况；
4. 走访对华虹集团所属代工厂，检索华虹集团公司网站，查阅华虹集团所属代工厂回函文件；

5. 查阅上海华虹、小米科技、深圳展想填写的问卷调查表以及该等股东出具的确认文件，检索企查查、国家企业信用信息公示系统，核查该等股东入股发行人相关情况；

6. 查阅发行人股东、董监高、核心技术人员填写的调查表以及相关确认文件；

7. 访谈小米集团、传音控股相关产品负责人；

8. 查询小米集团、传音控股的代工整机厂商所使用的芯片型号，并将发行人向中翔达润、深圳方成佰屹科技有限公司（以下简称“方成佰屹”）、长沙芯业电子有限公司（以下简称“芯业电子”）销售价格与其他客户相比较；

9. 查阅发行人出具的确认文件。

（二）核查意见

1. 说明相关有股权关系的供应商、客户入股发行人的背景、相关方集中入股发行人的原因，各期与发行人交易金额及占同类交易比例；相关方向发行人采购、销售的决策模式，是否由相关股东或其关联方主导。

（1） 相关有股权关系的供应商、客户入股发行人的背景、相关方集中入股发行人的原因

根据发行人主要管理人员的说明，2020 年下半年，发行人与上海华虹、小米科技、深圳展想等 7 名投资者同步沟通增资入股事宜；根据发行人提供的验资报告，深圳展想、义乌华芯、日照中融、宇信金、苏州元禾等 5 名投资者于 2020 年 12 月向公司完成缴款，上海华虹、小米科技等 2 名投资者于 2021 年 3 月向公司完成缴款。7 名投资者系看好发行人所处行业及发行人自身发展潜力，均采用了增资方式对发行人进行入股，入股价格均为 22.22 元/股，入股时不存在就采购/销售优惠价格、金额等进行相关利益安排的情形。

发行人引进的投资者上海华虹、小米科技、深圳展想分别持有发行人 0.47%、2.82%、0.47%股份，持股比例不高；其与发行人供应商、客户的具体关系、穿透后间接持股比例及出资层级情况如下表所列示：

发行人股东	持股比例	间接股东	与发行人供应商/客户的关系	间接持股比例	出资层级
上海华虹	0.47%	华虹集团	发行人供应商华力微、华虹宏力、华力集和无锡华虹均为华虹集团控制的下属企业	0.2820%	第二层
		华力微	系发行人供应商，同时与发行人供应商华虹宏力、华力集和无锡华虹系同一控制下的关联方	0.094%	第二层
		华虹宏力	系发行人供应商，同时与发行人供应商华力微、华力集和无锡华虹系同一控制下的关联方	0.094%	第二层
小米科技	2.82%	小米集团	系发行人产品的下游终端客户	2.82%	第四层
深圳展想	0.47%	传音控股	系发行人产品的下游终端客户	0.47%	第二层

发行人引进上海华虹入股的主要背景为：希望加深与华虹集团业务合作，稳定晶圆供应，保障业务发展；通过引进国有背景的股东，优化发行人股权结构，提升公司治理水平。

发行人引进小米科技、深圳展想入股的主要背景为：拓展芯片产品在小米、传音等知名品牌客户的应用，提升市场影响力和知名度；通过引进上市公司下属公司，优化发行人股权结构，提升公司治理水平。

同行业公司 IPO 前引进产业链上下游供应商、客户入股的情形较多，近期已上市或递交注册的案例具体如下表所列示：

公司名称	公司股东	发行前持股比例	入股时间	与供应商/客户的关系
中科蓝讯 (科创板递交注册)	上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）	1.33%	2019.12	间接股东中芯国际系该公司报告期内第一大供应商
	苏州聚源铸芯创业投资合伙企业（有限合伙）	0.50%	2020.10	
恒玄科技 (688608.SH)	湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	4.66%	2019.07	小米系公司产品的品牌应用客户

公司名称	公司股东	发行前 持股比 例	入股时 间	与供应商/客户的关系
	阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	3.73%	2019.07	阿里系公司产品的品 牌应用客户
东微半导 (688261.SH)	上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基 金中心（有限合伙）	9.95%	2018.05	间接股东中芯国际系 2019 年第五大供应商
国芯科技 (688262.SH)	国家集成电路产业投资基金股份有限公 司	8.63%	2018.08	系公司报告期内前五 大供应商华虹宏力、供 应商 A 之股东
芯朋微 (688508.SH)	国家集成电路产业投资基金股份有限公 司	8.87%	2019.09	系公司报告期内前五 大供应商长电科技、华 天科技之股东
纳芯微 (688052.SH)	上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基 金中心（有限合伙）	2.02%	2019.11	间接股东中芯国际系 报告期内前五大供应 商
	苏州聚源铸芯创业投资合伙企业（有限合 伙）	1.19%	2020.07	
峰昭科技 (688279.SH)	湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合 伙）	2.03%	2020.01	小米系公司产品的品 牌应用客户
格科微 (688728.SH)	湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合 伙）	0.95%	2020.03	小米系公司产品的终 端品牌客户
	深圳 TCL 战略股权投资基金合伙企业（有 限合伙）	0.48%	2020.03	TCL 系公司产品的终 端品牌客户
	SVIC	0.20%	2020.03	间接股东三星电子系 该公司报告期内第一 大供应商（晶圆制造）
	上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基 金中心（有限合伙）	0.64%	2020.03	间接股东中芯国际系 该公司申报报告期内 前二大供应商（晶圆代 工）
	SHANGHAI HUAHONG INTERNATIONAL , INC.	0.56%	2020.03	间接股东华虹集团系 公司 2020 年度第四大 供应商（晶圆制造）无

公司名称	公司股东	发行前 持股比 例	入股时 间	与供应商/客户的关系
				锡华虹的控股股东
	湖杉芯聚（成都）创业投资中心（有限合伙）	0.32%	2020.03	间接股东 SKHYNIXINC.系公司 供应商
	合肥石溪产恒集成电路创业投资基金合伙企业（有限合伙）	0.40%	2020.03	间接股东通富微电子系 公司供应商（封装测试）
唯捷创芯 (688153.SH)	OPPO 广东移动通信有限公司	3.39%	2020.12	OPPO 系公司产品的智能手机品牌客户
	湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	1.74%	2020.12	小米系公司产品的智能手机品牌客户
	稳懋开曼	0.50%	2021.05	间接股东稳懋系该公司报告期内第一大供应商

资料来源：各公司招股说明书。

（2） 相关方与发行人的交易金额及占同类交易比例

1） 发行人向上海华虹的相关方华虹集团采购情况

发行人法人股东上海华虹的股东为华虹集团、华力微和华虹宏力。报告期内，发行人的晶圆制造供应商华力微、华虹宏力、华力集和无锡华虹均系华虹集团下属企业，与上海华虹构成关联方。

报告期内，发行人主要向华虹集团下属企业采购晶圆和光罩，具体采购金额及占比情况如下表所列示：

单位：万元

公司名称	2021 年 1-9 月			2020 年度		
	采购金额	占发行人同类采购比例	占供应商同类销售比例	采购金额	占发行人同类采购比例	占供应商同类销售比例

公司名称	2021 年 1-9 月			2020 年度		
	采购金额	占发行人同类采购比例	占供应商同类销售比例	采购金额	占发行人同类采购比例	占供应商同类销售比例
华力集	112,836.06	91.78%	-	88,458.86	81.05%	-
华力微	2,359.00	1.92%	-	3,921.43	3.59%	-
无锡华虹	3,209.30	2.61%	1.79%	-	-	-
华虹宏力	286.04	0.23%	0.05%	-	-	-
合计	118,690.41	96.54%	-	92,380.29	84.64%	-

续上表：

公司名称	2019 年度			2018 年度		
	采购金额	占发行人同类采购比例	占供应商同类销售比例	采购金额	占发行人同类采购比例	占供应商同类销售比例
华力集	4,019.29	5.67%	-	-	-	-
华力微	34,234.64	48.30%	-	46,066.96	58.24%	-
无锡华虹	-	-	-	-	-	-
华虹宏力	-	-	-	-	-	-
合计	38,253.93	53.97%	-	46,066.96	58.24%	-

注 1：采购金额包括晶圆制造及光罩采购金额；

注 2：占发行人同类采购比例指采购金额占发行人同期晶圆和光罩采购总额的比例；

注 3：占供应商同类销售比例中，华力集、华力微无公开披露数据，未能获取占其同类销售比例；对无锡华虹、华虹宏力的比例为占其对外披露的晶圆收入比例，其中无锡华虹、华虹宏力披露的收入金额根据中国人民银行公布的汇率换算为人民币。

发行人对华虹集团的采购占比较高系 Fabless 模式经营所致，符合行业特点，不构成重大依赖，不会对公司生产经营形成重大不利影响。

根据华虹集团所属各晶圆代工厂公布的晶圆产能情况，推算发行人向各晶圆代工厂采购的晶圆占其产能的比例情况如下：

公司名称	披露的产能情况	发行人采购晶圆数量占晶圆代工厂年产能的比例			
		2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
华力集	设计月产能 4 万片	26.51%	15.75%	0.64%	-
华力微	设计月产能 3.5 万片	0.65%	0.81%	7.87%	10.56%
无锡华虹	月产能 4 万片	0.55%	-	-	-

华虹宏力	月产能约 18 万片	0.03%	-	-	-
合计	累计月产能约 29.5 万片	3.76%	8.78%	4.01%	4.93%

注：各晶圆代工厂月产能数据来自各公司官网，年产能按照月产能乘以 12 个月计算；发行人 2018 年-2020 年向华力集、华力微采购，2018 年-2020 年合计占比仅考虑华力集、华力微的合计产能。

由上表可见，公司向各晶圆代工厂采购的晶圆数量占其年产能的比例中，仅 2018 年度对华力微的比例 10.56%以及 2020 年度、2021 年 1-9 月对华力集的比例 15.75%、26.51%占比较大，主要系发行人在华力集建成后新产线磨合期（2019 年上半年）即与其展开合作，获得了较为充足的产能。同时，华力集是华力微的子公司，发行人将部分华力微的采购转为向华力集采购。除此之外，发行人对其他晶圆代工厂的年产能占比均较低。

2）发行人向小米科技相关方小米集团、深圳展想相关方传音控股的销售情况

发行人法人股东小米科技穿透后的最终股东为小米集团（1810.HK），深圳展想穿透后的最终股东为传音控股（688036.SH）。

小米集团和传音控股作为终端品牌厂商，不直接与发行人发生业务往来，由整机厂商（ODM/OEM）向发行人方案商客户采购发行人 SoC 芯片。发行人产品进入小米集团、传音控股的主要销售路径如下表所列示：

相关方		整机厂商（ODM/OEM）	方案商(发行人客户)	产品型号	报告期内对应产品销售占比
小米集团	北京小米电子产品有限公司、小米通讯技术有限公司	下游客户 1、下游客户 47	中翔达润	AC6926C8	2.15%
传音控股	传音控股	下游客户 48	方成佰屹	AD6976D4	19.72%
	深圳小传实业有	下游客户 49	芯业电子	AC6936D4	13.53%

相关方	整机厂商（ODM/OEM）	方案商（发行人客户）	产品型号	报告期内对应产品销售占比
限公司				

注 1：由于所处产业链条较长且涉及下游客户的商业秘密，发行人不掌握全部应用于小米集团、传音控股终端产品的产品型号及具体销售路径；上表中销售路径主要通过客户走访、访谈小米集团和传音控股相关产品负责人而知悉；

注 2：北京小米电子产品有限公司、小米通讯技术有限公司为小米集团全资子公司，深圳小传实业有限公司为传音控股全资子公司。

注 3：发行人不掌握三家方案商采购的该等型号产品最终应用的具体数据；报告期内对应产品销售占比为发行人报告期内销售给该方案商所列型号的全部产品金额占发行人对该方案商销售总额的比例。

报告期内，方案商客户中翔达润、方成佰屹、芯业电子向发行人采购多种型号的产品；其中，中翔达润向发行人采购的 AC6926C8、方成佰屹采购的 AD6976D4 以及芯业电子采购的 AC6936D4，部分最终应用于小米集团、传音控股的产品，三家方案商客户采购该等芯片产品金额分别占对该等客户向发行人总采购金额的 2.15%、19.72%以及 13.53%，占比较低。该等方案商不存在采购发行人产品后，最终仅应用于小米集团、传音控股产品的情形。

报告期内，发行人向中翔达润、方成佰屹以及芯业电子销售的该等产品金额、占发行人同类产品销售金额的比例如下表所列示：

单位：万元

公司名称	产品型号	2021 年 1-9 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
		销售金额	占比	销售金额	占比	销售金额	占比	销售金额	占比
中翔达润	AC6926C8	186.24	0.10%	441.58	0.21%	604.36	0.36%	186.12	0.14%
方成佰屹	AD6976D4	12.79	0.01%	41.05	0.02%	-	-	-	-
芯业电子	AC6936D4	116.81	0.06%	788.00	0.37%	143.36	0.09%	-	-
合计		315.84	0.17%	1,270.63	0.60%	747.72	0.45%	186.12	0.14%

注：占比指销售金额占发行人同期 SoC 芯片销售总额的比例；发行人不掌握中翔达润、

方成佰屹和芯业电子向小米集团、传音控股的代工厂商的具体销售数量，故按方案商采购该具体型号总金额进行测算。

报告期内，发行人向中翔达润、方成佰屹和芯业电子销售相关具体型号产品的金额较小，占比较低；发行人不存在向小米集团、传音控股大规模销售的情况。

报告期内，发行人向中翔达润、方成佰屹以及芯业电子销售的相关型号产品与向其他客户销售同型号产品比较：

2021年1-9月，发行人向芯业电子销售的AC6936D4销售单价、毛利率较其他客户高28.67、15.95个百分点，主要系发行人向芯业电子销售的AC6936D4均发生于2021年第一季度，当季度对其他客户的AC6936D4销售单价、毛利率与芯业电子差异较小。除此之外，发行人向中翔达润、方成佰屹以及芯业电子销售的上述型号产品与向其他客户销售同型号产品的销售单价差异率均在10%以内且大部分差异率低于5%；毛利率差异率均在5个百分点以内且大部分差异率低于3个百分点，差异较小，销售价格公允。

（3） 相关方向发行人采购、销售的决策模式，是否由相关股东或其关联方主导

1）华虹集团下属企业对发行人的销售决策模式，不存在由上海华虹或其关联方主导的情形

发行人作为以Fabless模式经营的集成电路设计企业，与华虹集团所属晶圆代工厂属于集成电路产业链上下游，双方的业务往来系基于产业链的市场化交易。报告期内，发行人一般结合产品畅销度、客户预计需求及上游产能情况提前与华力集、华力微等晶圆厂商预约下一年度产能。华力集、华力微等晶圆厂商根据各家客户的产能需求和自身经营策略进行产能分配，并履行内部决策审批程序，由销售经理、销售总监和副总裁逐层审批。

在具体销售过程中，华力集、华力微等晶圆厂商一般以提供报价单的方式向下游客户进行报价，由客户根据自身生产需求提交采购订单，华力集、华力微等晶圆厂商履行订单审批流程后开始组织生产。

根据华力集、华力微等晶圆厂商以及上海华虹出具的确认函，华力集、华力微等晶圆厂商与杰理科技业务合作的订单获取、业务达成等均与上海华虹无涉，业务往来及相关决策均由晶圆厂商自行决定主导，不存在上海华虹主导晶圆厂商与杰理科技业务合作的情形。

因此，报告期内，华力集、华力微、无锡华虹以及华虹宏力向发行人销售晶圆等产品系晶圆厂商自主经营决策，不存在由发行人股东上海华虹主导的情况。

2) 小米集团、传音控股间接对发行人的采购决策模式，不存在由小米科技、深圳展想或其关联方主导的情形

A. 小米集团间接向发行人采购的决策模式

小米集团应用发行人 SoC 芯片的主要产品为小米小爱随身音箱，该产品于 2018 年 12 月即已量产，2019 年进行了迭代升级。小米集团向上游整机厂商委托生产小米小爱随身音箱过程中，并未要求整机厂商（ODM/OEM）指定采用发行人的 SoC 芯片，整机厂商可自主选择符合产品设计要求的 SoC 芯片。因此，小米集团或其关联方未主导上游整机厂商或方案商向发行人采购 SoC 芯片。

发行人方案商客户中翔达润采购发行人芯片、经二次开发后销售给下游整机厂商，最终应用于蓝牙耳机、蓝牙音箱等终端产品，其中 AC6926C8 蓝牙音箱芯片部分应用于小米小爱随身音箱。中翔达润向发行人的采购系基于其自主经营决策，不存在由小米科技或其关联方主导的情形。

B. 传音控股间接向发行人采购的决策模式

传音控股应用发行人 SoC 芯片的主要产品包括 XE15、KT1、KT1S 等 TWS 蓝牙耳机，传音控股系根据自身产品的方案需求适用性匹配到发行人的 SoC 芯片，并委托上游整机厂商（ODM/OEM）进行生产及相关元器件采购；方成佰屹和芯业电子根据整机厂商的需求向发行人进行采购，系市场化商业行为。报告期内，方成佰屹和芯业电子向发行人采购过程中涉及的商务谈判、产品定价、合同/订单签订及审批等环节均由其自主参与和决策，不存在由传音控股或其关联方主导的情况。

发行人方案商客户方成佰屹、芯业电子采购发行人芯片、经二次开发后销售给下游整机厂商，最终应用于蓝牙耳机、蓝牙音箱等终端产品，其中 AD6976D4、AC6936D4 部分应用于传音控股 TWS 蓝牙耳机。方成佰屹、芯业电子向发行人的采购系基于其自主经营决策，不存在由传音控股或其关联方主导的情形。

综上，本所律师认为，上海华虹、小米科技、深圳展想入股价格与其他投资人入股价格相同；发行人引进该等股东主要系加深与晶圆代工厂的合作、拓展品牌客户，保障公司业务发展，同时优化股权结构，提升公司治理水平；相关方向发行人采购、销售由交易各方自主决策，并非由上海华虹、小米科技或其关联方、深圳展想或其关联方主导。

2. 结合与华力微、华虹宏力、华力集和无锡华虹等的合作时间、报告期各期采购金额、各季度采购同比及环比变动情况、入股前后采购金额及变动情况等，说明上海华虹入股发行人前后向发行人销售金额是否发生明显变化，是否与华虹集团就采购价格、金额等进行相关利益安排。

（1）晶圆代工厂华力微、华力集、无锡华虹、华虹宏力均系国内规模较大的国有企业，上海华虹持股发行人比例较低、入股价格与同期其他股东入股价格一致

晶圆代工厂华力微、华力集、华虹宏力、无锡华虹基本情况如下表所列示：

企业名称	成立时间	注册资本	股东情况	简要介绍
华力微	2010 年 1 月	220.72 亿元	控股股东华虹集团持股 53.79%，实际控制人上海市国资委	华力微（简称“华力一期”）建有中国大陆第一条 12 英寸全自动集成电路芯片制造生产线，工艺水平主要为 65/55 纳米，设计月产能 3.5 万片，2011 年 4 月建成投片。
华力集	2016 年 8 月	296 亿元	控股股东华力微持股 54.05%，实际控制人上海市国资委	华力集（简称“华力二期”）系国家“十三五”集成电路产业重大项目，规划工艺水平覆盖 55 纳米、40 纳米、28/22 纳米和 14 纳米等，设计月产能 4 万片，2018 年 10 月建成投片。

企业名称	成立时间	注册资本	股东情况	简要介绍
华虹宏力	2013 年 1 月	78.29 亿元	控股股东华虹半导体（01347.HK）持股 100%，实际控制人上海市国资委	建有中国大陆第一条 8 英寸集成电路生产线，目前共有三座 8 英寸晶圆厂，月产能约 18 万片。
无锡华虹	2017 年 10 月	18 亿美元	控股股东华虹半导体（01347.HK）直接及间接合计持股 51%，实际控制人上海市国资委	中国大陆领先的 12 英寸特色工艺生产线，也是全球第一条 12 英寸功率器件代工生产线，设计月产能 4 万片，2019 年 9 月建成投产。

注：上表中各晶圆代工厂信息主要来自企查查、企业官网。

华力微、华力集、无锡华虹、华虹宏力均为国内规模较大、知名度较高的晶圆代工国有企业，实际控制人均为上海市国资委。上海华虹系华虹集团下属投资平台，股东华虹集团持股 60%、华虹宏力持股 20%、华力微持股 20%。

上海华虹于 2020 年 11 月开始与发行人接洽入股事宜，并于 2021 年 3 月向发行人增资 4,000 万元，增资比例 0.47%，出资金额较小、持股比例较低，增资价格 22.22 元/股，按达成投资意向向前一年市盈率倍数为 20.34 倍，与同期日照中融、宇信金、义乌华芯、深圳展想、苏州元禾、小米科技增资价格一致，入股市盈率倍数较高，入股价格公允。

（2）公司与华力微、华力集、无锡华虹、华虹宏力的合作时间均在上海华虹入股之前，双方业务规模的增长主要系下游市场需求的快速增长以及业务合作的持续加深

报告期内，公司对华力微、华虹宏力、华力集和无锡华虹的晶圆采购规模，双方合作时间具体如下表所列示：

公司名	企业历程	合作时间	晶圆采购金额（万元）
-----	------	------	------------

称			2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
华力微	2015 年 3 月， 12 寸生产线项目竣工验收	2016 年 7 月开始 合作	2,359.00	3,921.43	34,200.77	45,769.29
华力集	2018 年 10 月 建成投产	2019 年 5 月开始 合作	112,236.59	87,319.01	3,353.19	-
无锡华虹	2019 年 9 月建 成投产	2020 年 11 月开始 合作	2,149.98	-	-	-
华虹宏力	境内 8 英寸晶 圆主要代工厂 之一	2020 年 12 月开始 合作	244.34	-	-	-
合计			116,989.90	91,240.45	37,553.95	45,769.29

注：上表中企业历程来自各公司官网；采购金额仅为晶圆制造采购，不含光罩采购。

报告期内，公司向华力微、华力集、无锡华虹的采购合作，主要开始自该等晶圆代工厂产线建成投产后次年，业务合作密切；公司向华虹宏力采购的 8 英寸晶圆，系受 0.153um 等较低工艺制程芯片市场需求旺盛、晶圆产能紧张影响，公司自 2020 年开始导入华虹宏力的 8 英寸晶圆。

报告期各期，公司对华力微、华力集、无锡华虹和华虹宏力的晶圆采购金额合计分别为 45,769.29 万元、37,553.95 万元、91,240.45 万元以及 116,989.90 万元。其中 2020 年以及 2021 年 1-9 月采购规模快速增长，主要系发行人于 2019 年下半年推出的 AC695N、AC696N，2020 年推出的 AC697N、AC698N 所需晶圆均系向华虹集团采购；同时，受 TWS 蓝牙耳机芯片需求持续增长以及上游晶圆产能紧张影响，公司持续加大晶圆采购规模。

公司对华力集的采购规模增长较快，主要原因为：华力集晶圆生产线于 2018 年 10 月建成投产，公司于 2019 年上半年即与华力集合作，成为最早获得华力集晶圆产能的 IC 设计企业之一，而公司凭借规模优势，协助华力集快速提升产能，实现双方互惠互利，公司获得的华力集晶圆产能亦持续增加。

华力集为华力微新建生产线（亦为下属子公司），规划工艺水平覆盖 55nm、40nm、28nm 等更高工艺制程。公司 IC 设计主要为逻辑射频混合电路，有利于协助新生产线产能快速提升，公司部分 55nm 相关晶圆在华力集新生产线磨合成功，对华力微的采购逐步转向华力集，并使得华力微的产能得以释放；同时，随着公司 40nm、28nm 工艺制程相关晶圆在华力集成功量产，公司对华力集的采购逐年增加。

（3）上海华虹入股发行人前后，发行人向华虹集团采购的晶圆同比增幅较为稳定，环比增幅有所下降

1）发行人向华虹集团采购的晶圆各期同比、环比变动情况

报告期内，发行人对华虹集团各季度的晶圆采购金额、同比增长、环比增长情况如下表所列示：

单位：万元

季度	2021 年 1-9 月			2020 年度		
	采购金额	同比增长	环比增长	采购金额	同比增长	环比增长
第一季度	40,449.82	113.95%	18.66%	18,906.51	194.77%	40.48%
第二季度	41,307.23	116.88%	2.12%	19,046.29	113.32%	0.74%
第三季度	35,232.85	83.51%	-14.71%	19,199.72	119.35%	0.81%
第四季度	-	-	-	34,087.92	153.28%	77.54%
合计	116,989.90	-	-	91,240.45	-	-

续上表：

季度	2019 年度			2018 年度		
	采购金额	同比增长	环比增长	采购金额	同比增长	环比增长
第一季度	6,413.94	-15.18%	-30.05%	7,561.52	-	-

季度	2019 年度			2018 年度		
	采购金额	同比增长	环比增长	采购金额	同比增长	环比增长
第二季度	8,928.50	-24.72%	39.20%	11,860.67	-	56.86%
第三季度	8,752.95	-49.05%	-1.97%	17,178.38	-	44.83%
第四季度	13,458.57	46.79%	53.76%	9,168.73	-	-46.63%
合计	37,553.95	-	-	45,769.29	-	-

A. 同比增幅方面：

上海华虹于 2020 年 11 月与发行人开始接洽，发行人 2020 年第四季度同比增幅 153.28%、2021 年第一季度同比增幅 113.95%，2020 年第四季度增幅提升主要受市场产能紧张影响，公司加大备货力度所致；2021 年第一季度同比增幅恢复，上海华虹与发行人接洽后不存在增幅持续异常提升的情形。上海华虹于 2021 年 3 月入股发行人，发行人 2021 年第一季度同比增幅为 113.95%、第二季度同比增幅为 116.88%，增幅较为接近，上海华虹入股后同比增幅不存在明显异常的情形。

B. 环比增幅方面：

2020 年底，受晶圆产能持续紧张影响，公司为保障业务的持续稳定，加大了备货力度，2020 年第四季度环比增幅较大，而随着基期采购规模的提升，2021 年第一季度、第二季度环比增幅均有所下降，未出现环比增幅持续异常扩大的情形，符合公司业务开展情况，上海华虹于 2020 年 11 月与发行人接洽后、于 2021 年 3 月入股发行人后环比增幅均不存在明显异常的情形。

2) 发行人销售收入各期同比、环比变动情况

报告期内，发行人各季度的销售收入金额以及同比增长、环比增长情况如下表所列示：

单位：万元

季度	2021 年 1-9 月			2020 年度		
	销售金额	同比增长	环比增长	销售金额	同比增长	环比增长
第一季度	52,964.07	39.81%	-27.69%	37,884.01	23.06%	-30.65%
第二季度	73,802.17	121.11%	39.34%	33,377.93	-5.15%	-11.89%
第三季度	65,273.66	-6.23%	-11.56%	69,612.97	54.21%	108.56%
第四季度	-	-	-	73,241.13	34.08%	5.21%
合计	192,039.91	-	-	214,116.04	-	-

续上表：

季度	2019 年度			2018 年度		
	销售金额	同比增长	环比增长	销售金额	同比增长	环比增长
第一季度	30,783.91	20.97%	-14.17%	25,447.83	-	-
第二季度	35,188.40	-2.41%	14.31%	36,056.06	-	41.69%
第三季度	45,140.22	24.29%	28.28%	36,319.03	-	0.73%
第四季度	54,624.42	52.30%	21.01%	35,866.20	-	-1.25%
合计	165,736.95	-	-	133,689.12	-	-

报告期内，发行人一般结合上游晶圆产能情况、下游产品畅销程度等多方面因素进行晶圆备货。近年来，受上游晶圆产能紧张、下游需求持续旺盛影响，公司为保证经营的持续与稳定，尽可能获取更多晶圆产能、增加晶圆采购量，相应导致晶圆采购与销售收入变动不存在明显的匹配关系。

从变动趋势来看，发行人自 2019 年下半年开始，收入增幅扩大，2019 年第四季度晶圆采购亦大幅增加；2020 年上半年受疫情影响，下游复工延迟，当期销售环比下降，而境内晶圆厂受疫情影响较小，生产较为正常，公司晶圆采购规模持续增加；2020 年下半年，疫情缓解，下游需求反弹式增长，收入增幅较大；2020 年第四季度以来，市场预期晶圆产能紧张程度加剧，公司扩大了晶圆备货规模，相应导致当期晶圆采购增幅提升；2021 年上半年，下游市场需求持续旺盛，公司销售收入、晶圆采购同比增幅趋势一致；2021 年第三季度，公司晶圆备货力度仍较大，同比增幅较高。

综上，公司晶圆采购规模变动与销售收入变动差异较大，主要系市场环境变化以及上游晶圆产能紧张，公司持续加大晶圆备货力度所致。

（4）上海华虹入股发行人前后采购金额不存在异常变动的情形

1）上海华虹入股发行人前后采购金额比较

上海华虹于 2021 年 3 月向发行人增资持股，入股前后发行人对华虹集团的晶圆采购情况如下表所列示：

单位：万元

期间	入股前采购金额	入股后采购金额	入股后增幅
入股前后 1 个月（2021 年 3 月、2021 年 4 月）	14,543.27	14,252.00	-2.00%
入股前后 3 个月（2021 年第一季度、2021 年第二季度）	40,449.82	41,307.23	2.12%
入股前后 6 个月（2020 年 10 月-2021 年 3 月、2021 年 4-9 月）	74,537.74	76,540.08	2.69%

由上表可见，上海华虹入股发行人前后，发行人对华虹集团的晶圆采购金额较为接近，不存在异常变动的情形。

2）上海华虹与发行人接洽前后采购金额比较

上海华虹于 2020 年 11 月与发行人开始接洽入股事宜，接洽前后发行人对华虹集团的晶圆采购情况如下表：

单位：万元

期间	接洽前采购金额	接洽后采购金额	接洽后增幅
接洽前后 1 个月 （2020 年 11 月、2020 年 12 月）	11,743.67	14,307.20	21.83%

期间	接洽前采购金额	接洽后采购金额	接洽后增幅
接洽前后 3 个月 (2020 年 9-11 月、2020 年 12 月以及 2021 年 1-2 月)	29,167.86	40,213.75	37.87%
接洽前后 6 个月 (2020 年 6-11 月、2020 年 12 月以及 2021 年 1-5 月)	50,260.42	81,275.30	61.71%

上海华虹与公司于 2020 年 11 月开始接洽入股事宜，上海华虹作为国有企业，接洽后历经其中介尽调、国资评估、内部审议等多项流程，至 2021 年 3 月方与发行人签署正式协议并增资入股，增资比例 0.47%，持股比例较低，增资价格 22.22 元/股，与同期日照中融、宇信金、义乌华芯、深圳展想、苏州元禾、小米科技增资价格一致。

2020 年第四季度以来，市场预期晶圆产能紧张程度加剧，公司持续扩大了晶圆备货规模，上表中接洽前后采购金额的变化主要系市场因素影响所致，与上海华虹接洽发行人关系较小。

根据华力集、华力微等晶圆厂商以及上海华虹出具的确认函，华力集、华力微等晶圆厂商与杰理科技业务合作的订单获取、业务达成等均与上海华虹无涉，业务往来及相关决策均由晶圆厂商自行决定主导，不存在上海华虹主导晶圆厂商与杰理科技业务合作的情形。

(5) 发行人不存在与华虹集团就采购价格、金额等进行相关利益安排的情形

发行人与上海华虹签订了《投资协议》《股东协议》《终止特殊股东权利之协议》，该等协议中不存在发行人与华虹集团就采购优惠价格、金额等进行相关利益安排的条款。

同时，上海华虹确认：“本公司在入股杰理科技时不存在就杰理科技对华虹集团的采购优惠价格、采购金额等进行相关利益安排的情形。”

综上，本所律师认为，上海华虹入股发行人前后，发行人对华虹集团的采购金额不存在明显异常的情形，发行人与华虹集团不存在就采购价格、金额等进行相关利益安排的情形。

3. 请保荐人、发行人律师按照《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》《监管规则适用指引——发行类第 2 号》的要求，逐条认真落实核查工作，完善专项核查报告。

本所律师已按照《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》《监管规则适用指引——发行类第 2 号》的要求，逐条认真落实核查工作，并出具《国浩律师（深圳）事务所关于珠海市杰理科技股份有限公司股东信息披露专项核查报告》，具体内容详见专项核查报告。

本补充法律意见书正本肆份，无副本。

（以下无正文，下接签署页）

本页无正文
为
国浩律师（深圳）事务所
关于
珠海市杰理科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
补充法律意见书（二）
的
签署页

国浩律师（深圳）事务所

负责人：

马卓檀

经办律师：

幸黄华

王 佳

2022 年 4 月 18 日